

株式会社 東京精密 2017年度(平成30年3月期) 決算説明会

2018年5月15日

◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- ▶ 本資料に記載されている情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ▶ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ▶ 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ 表記データ・用語について

- ▶ 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」と記載します。
- ▶ 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

◆ 監査について

- ▶ 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 新 中期目標
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ 質疑応答

単位：億円	2016年度	2017年度	
	通期実績	通期実績	前期比
売上高	778	882	+13%
半導体製造装置	503	595	+18%
計測機器	275	287	+4%
営業利益	137	173	+27%
半導体	88	113	+28%
同率	18%	19%	-
計測	48	60	+24%
同率	18%	21%	-
経常利益	139	173	+25%
<small>親会社株主に帰属する</small> 当期純利益	99	127	+28%
1株配当	72円	92円	+20円

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

4

- 2017年度は、半導体の堅調と計測の復調を主因に増収、各利益は過去最高を更新
売上高 882億円(半導体595億円、計測287億円)
営業利益 173億円(同113億円、60億円)
経常利益は173億円、親会社株主に帰属する当期純利益(以下純利益)は127億円
- 1株配当は、期末配当51円、通期92円
(20円増配。詳細は2018年5月15日付ニュースリリースをご覧ください。)
- 内外グループ社員全員に特別賞与支給

単位: 億円	2016年度				2017年度				前 四半期比 Q/Q	前年 同期比 Y/Y
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	163	209	195	211	199	238	192	253	+31%	+20%
半導体	110	133	132	128	142	161	126	166	+32%	+29%
計測	53	76	63	83	57	76	67	87	+30%	+5%
営業利益	29	37	32	39	40	49	36	48	+32%	+21%
半導体	22	22	21	23	31	33	22	28	+27%	+22%
同率	20%	17%	16%	18%	22%	20%	17%	17%		
計測	6	15	11	16	9	16	14	20	+38%	+21%
同率	12%	20%	17%	20%	16%	22%	22%	23%		
経常利益	26	37	35	41	41	49	36	46	+27%	+14%
親会社株主に帰属する 当期純利益	19	28	14	39	29	35	26	38	+44%	-3%

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

5

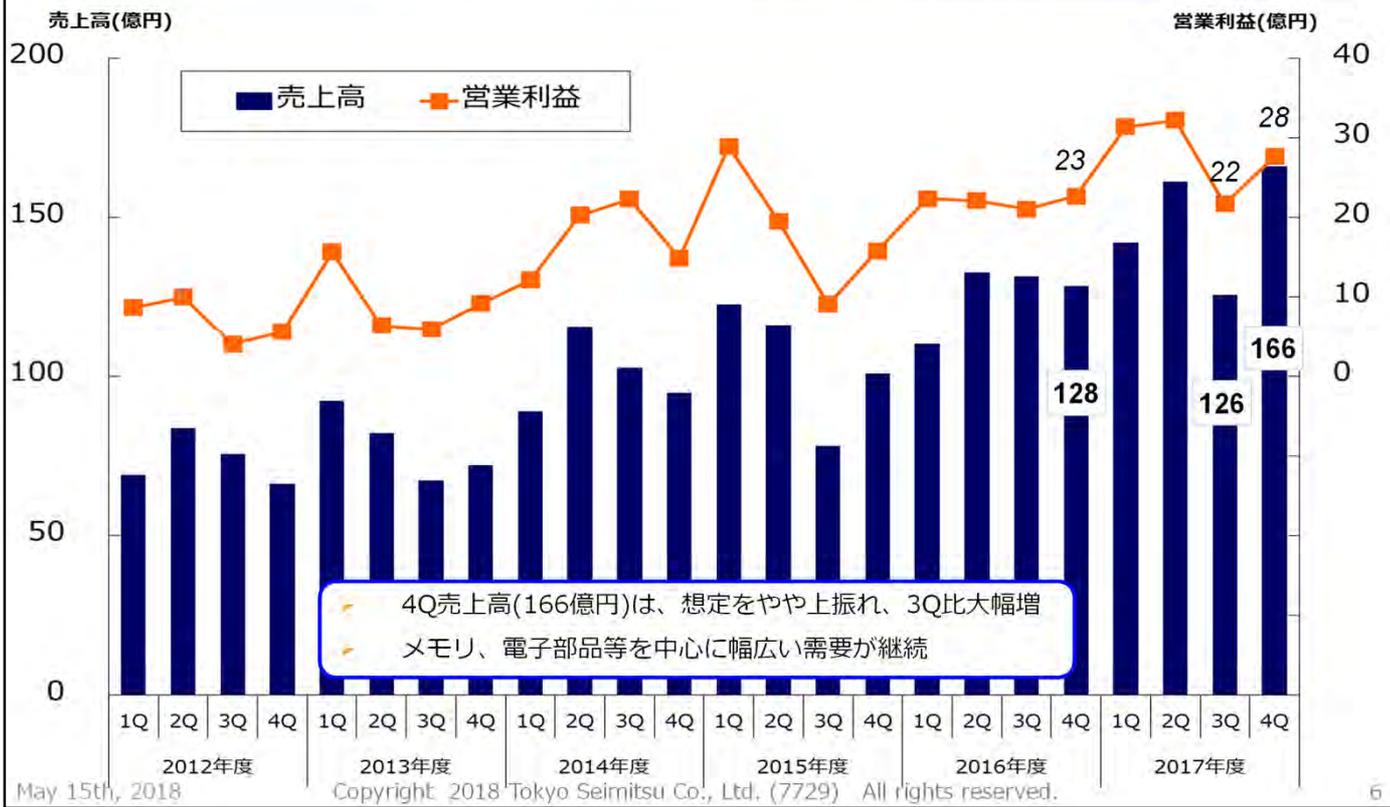
○ 2017年度第4四半期(1-3月、以下4Q)の業績概要

売上高 253億円(半導体166億円、計測87億円)

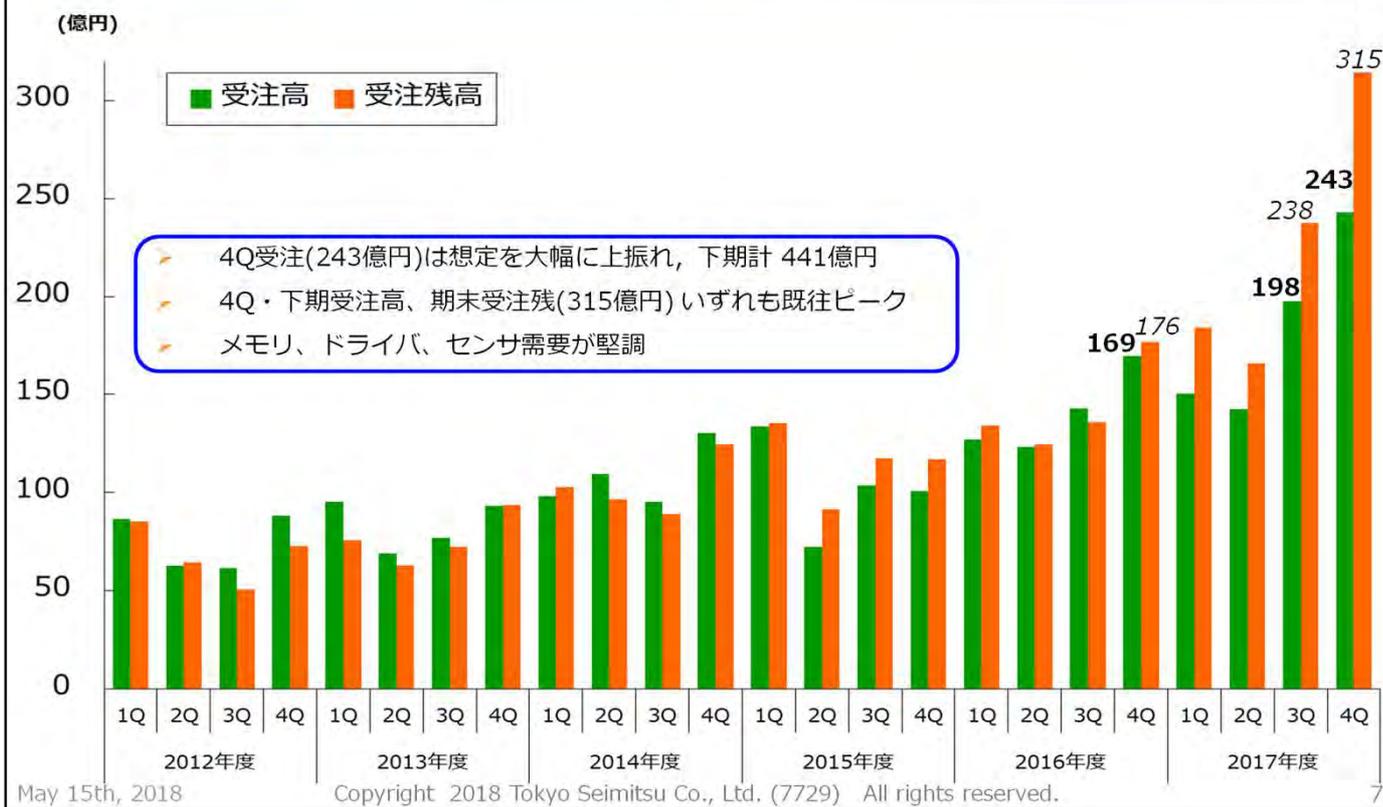
営業利益48億円(同28億円、20億円)

経常利益46億円、純利益38億円

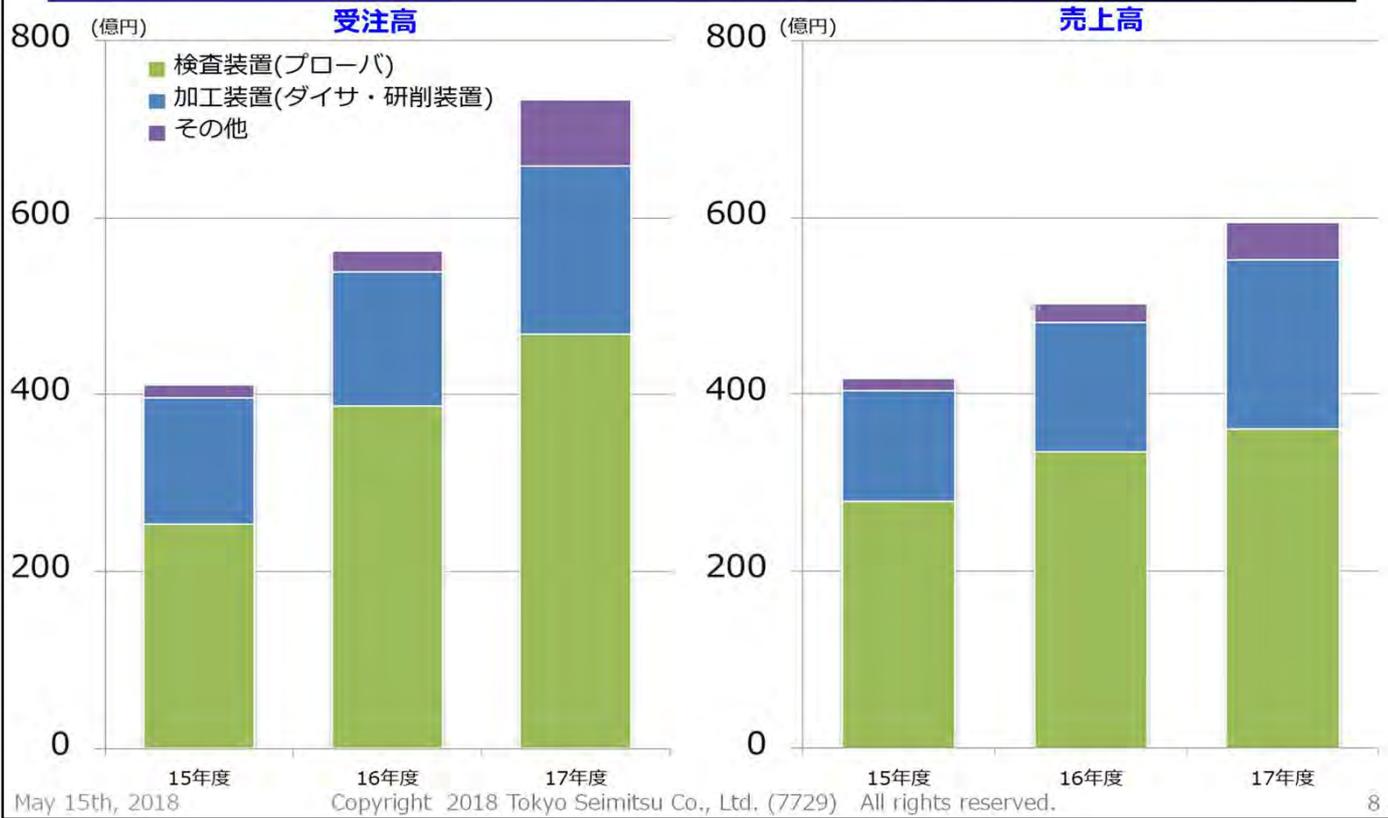
○ 4Q半導体営業利益率が3Q比微減 (特別賞与による経費増と製品ミックスが主因)



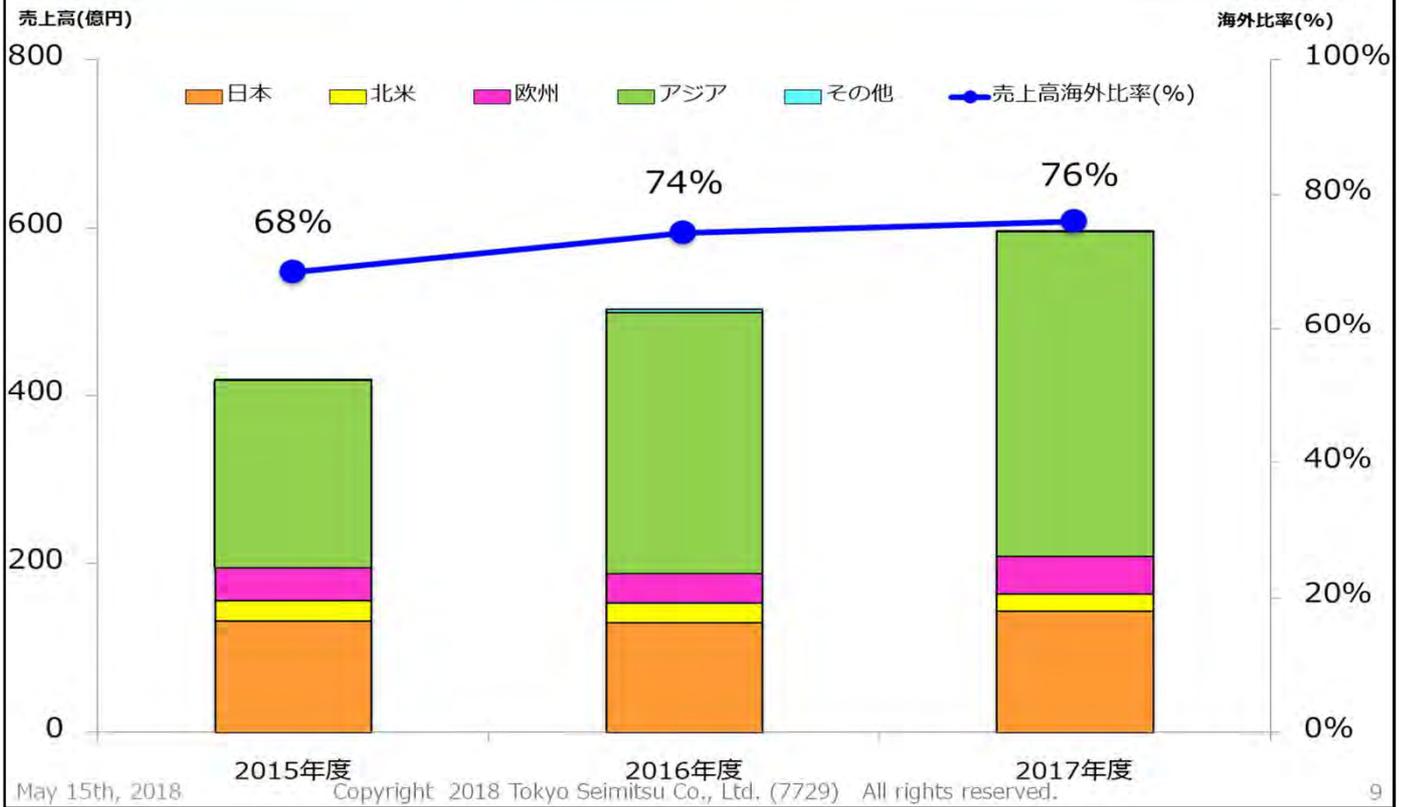
○ 4Q売上高は3Q比で大幅に増加、想定を上振れる着地



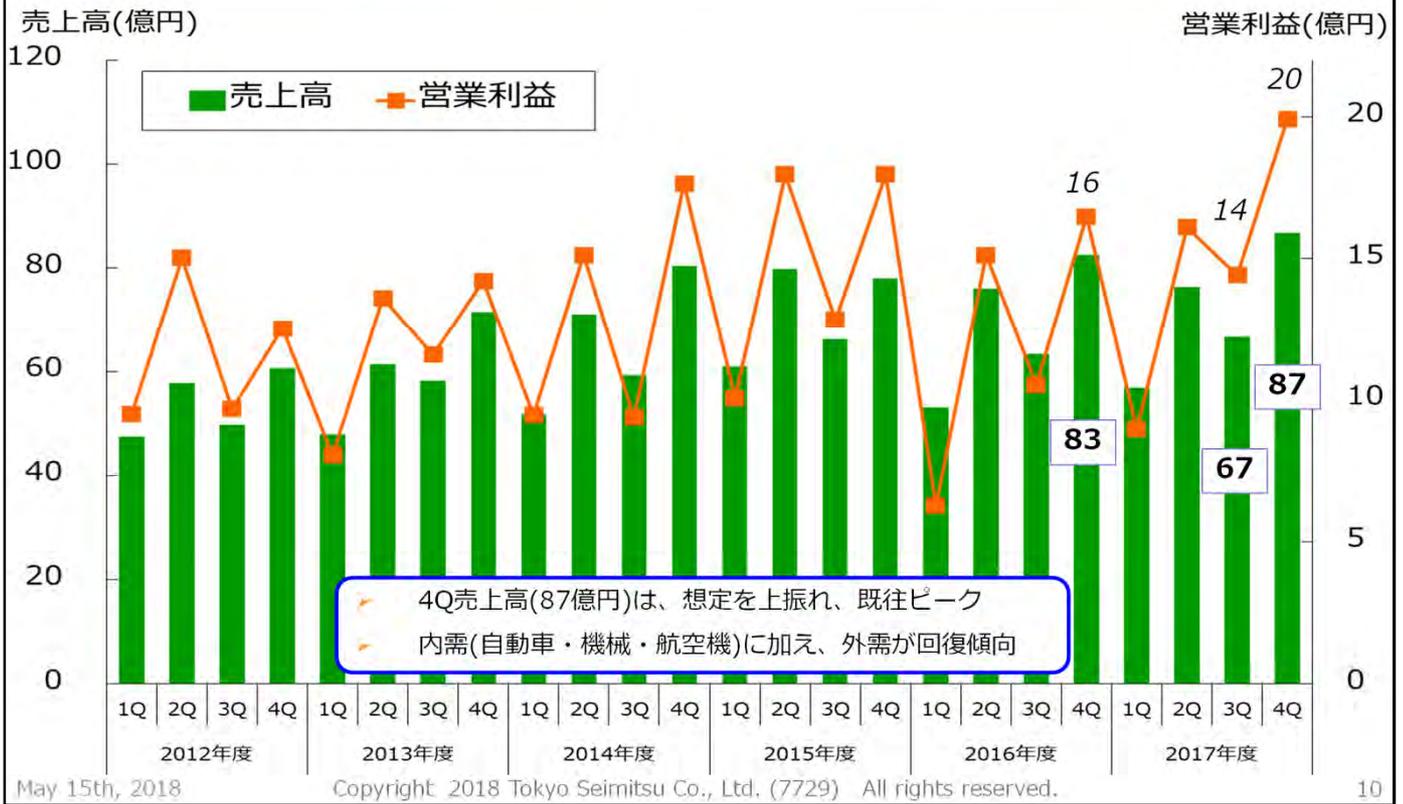
- 4Q受注は当初3Q並みを想定
メモリ、LCDドライバ、センサ向けの引合が想定を上回り、3Q比大幅増
- 4Q受注高、下期受注高、期末受注残高は過去最高を更新



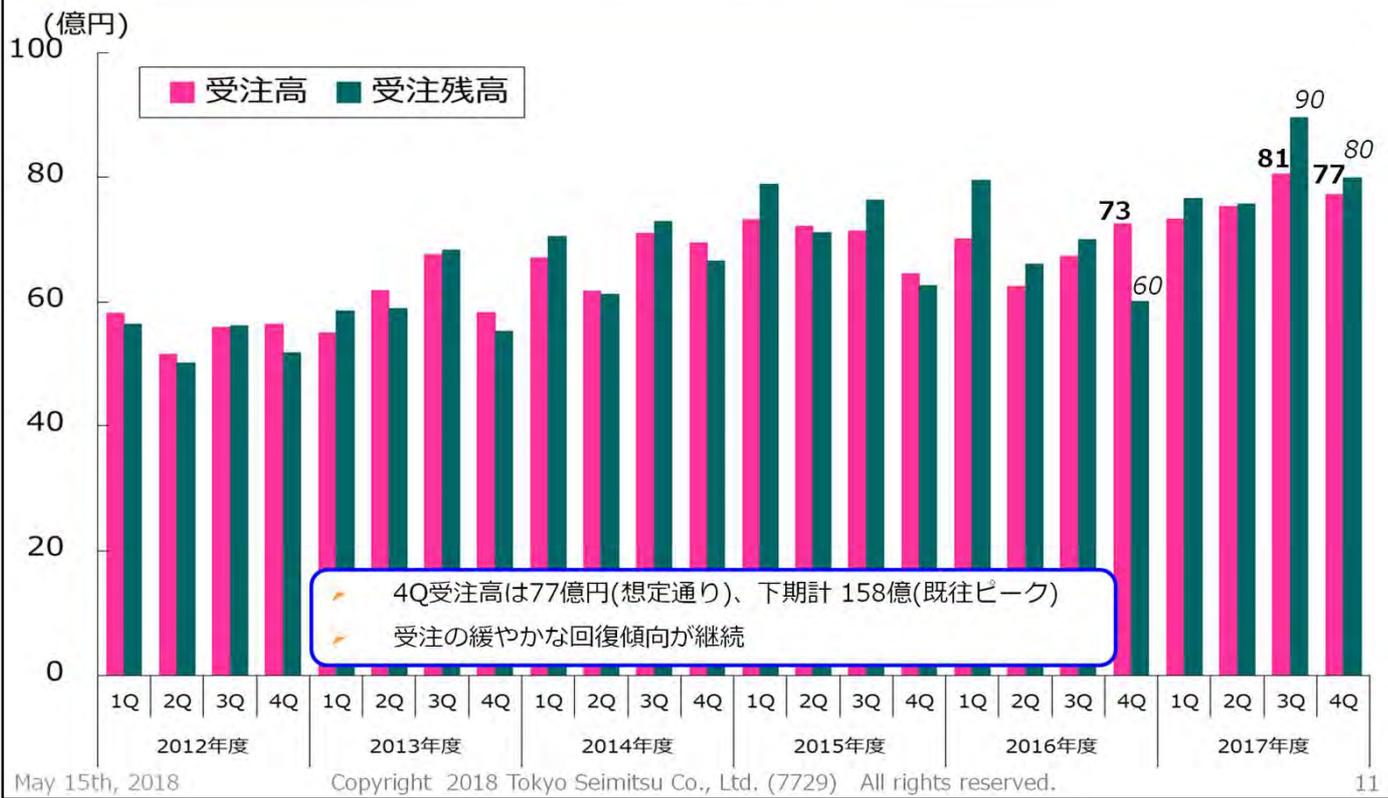
- 17年度は各製品とも受注高が増加
構成比は、検査装置（プローバ）6割台半ば、加工装置（ダイサ、研削装置）2割台半ば
- 売上は特に加工装置が増加
構成比は 検査装置 ほぼ6割、加工装置3割台前半



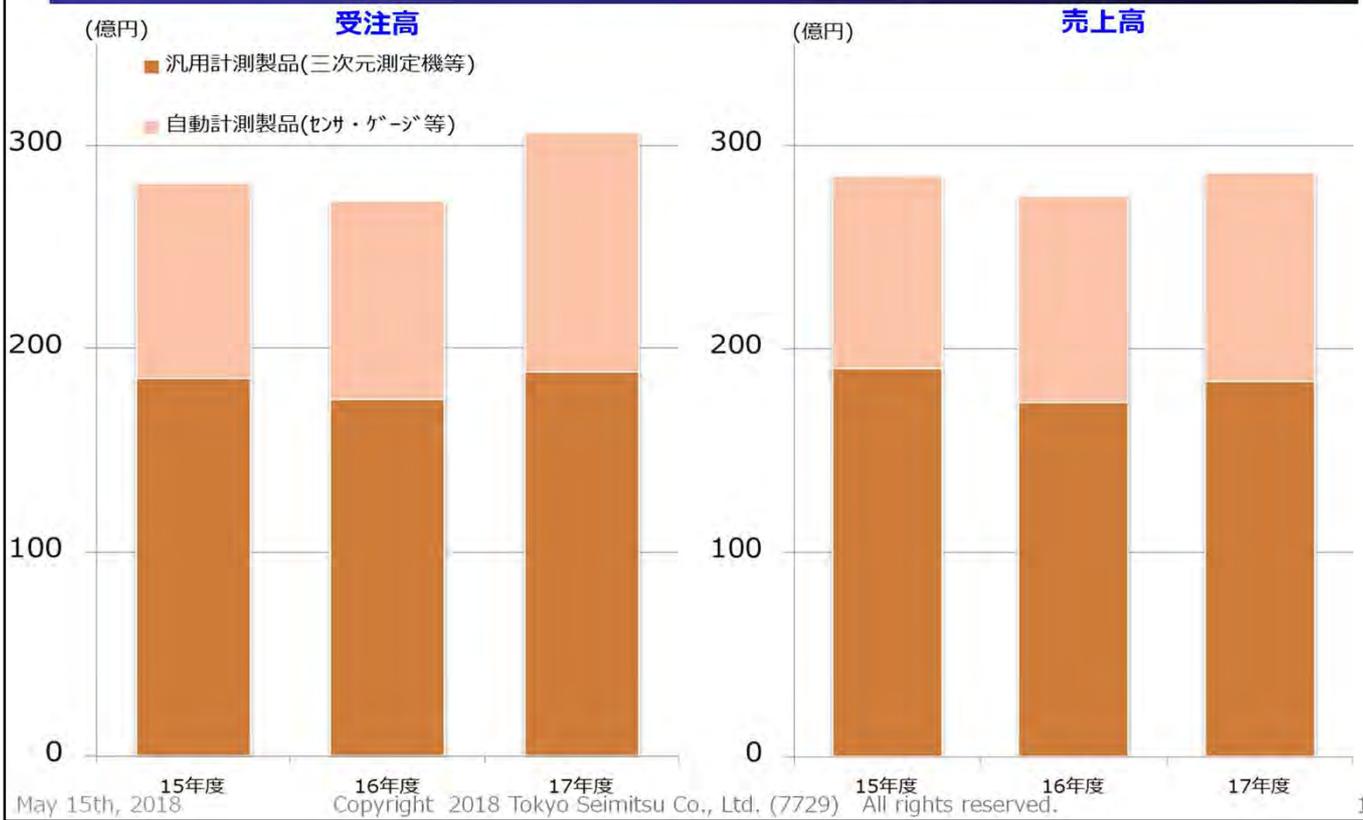
- 海外売上高比率は76%
- アジア向けが増加（特に東南アジア、韓国向け）



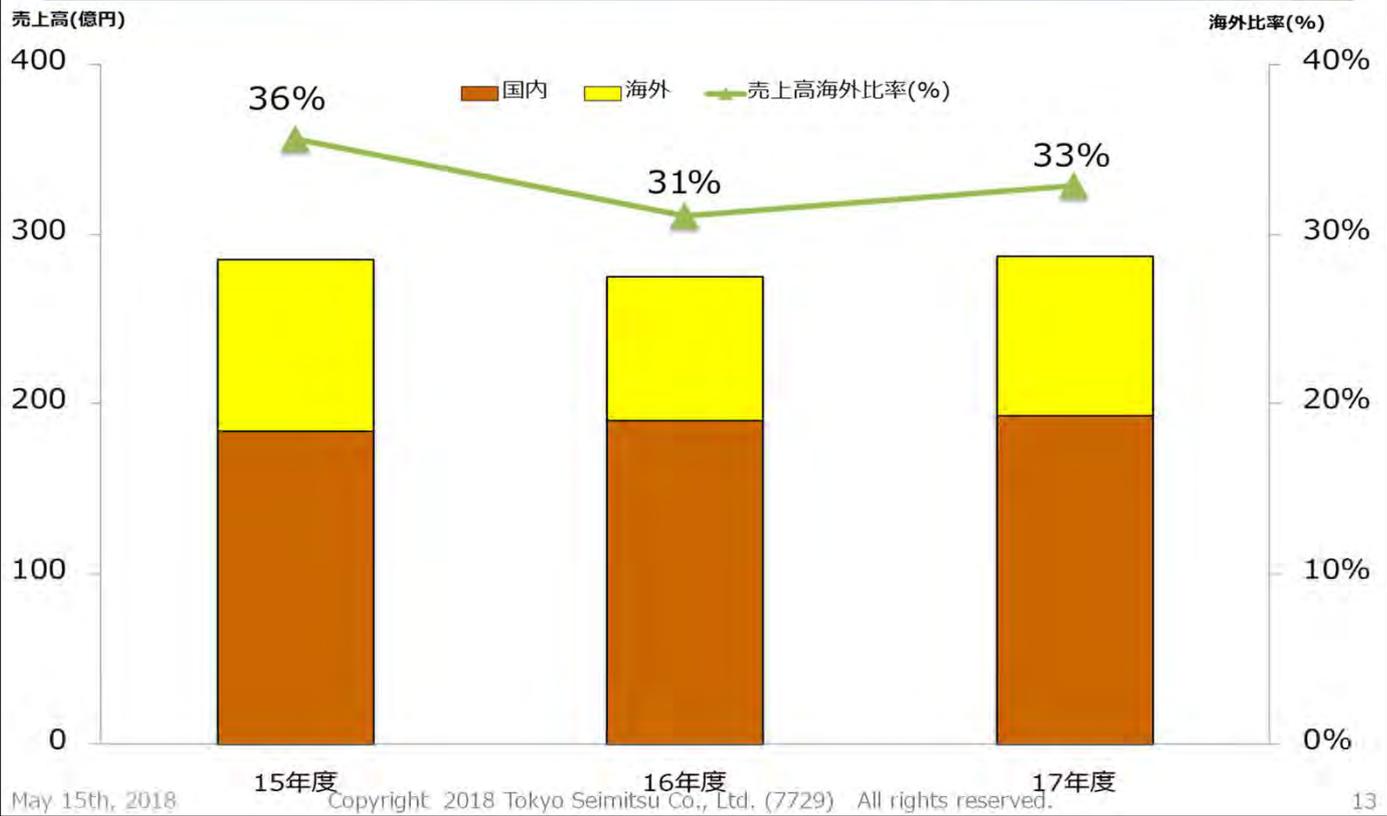
- 4Q売上高は、期末納期案件が多かったこと並びに 外需回復により 四半期ベースの過去最高を更新
- 営業利益も高水準



- 下期受注高は158億円（過去最高を更新）
自動車業界向け引合、センサ・ゲージ類（工作機械に連動）の引合を主因に
緩やかな受注回復が継続
- 期末受注残高は引き続き高水準を維持



- 17年度は受注・売上とも自動計測製品（センサ・ゲージ類等）が期を通じて堅調
汎用計測製品（三次元座標測定器等）も16年度比で復調
- 受注構成比は、汎用計測 ほぼ6割、自動計測 ほぼ4割
売上構成比は、汎用計測 6割台前半、自動計測 3割台前半



- 17年度 海外売上高比率は、33%
国内売上高は前年並み、日系メーカー海外投資復調により、海外比率が増加

資産 (億円)	17/3末	18/3末	増減	負債/純資産 (億円)	17/3末	18/3末	増減
現預金	339	372	+34	支手・買掛金, 電子記録債務	158	219	+61
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	284	334	+50	短期借入金	13	13	±0
在庫	173	223	+50	その他	95	96	+1
その他	32	34	+1	流動負債計	266	328	+62
流動資産計	828	963	+136	固定負債計	7	8	+1
固定資産計	317	366	+50	負債計	273	336	+64
資産合計	1,145	1,330	+185	純資産	872	994	+122
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	1,145 (13)	1,330 (13)	+185 (±0)

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

14

- 3月末の総資産は1,330億円 (前年末比185億円増)
- 資産増加の内訳は
流動資産136億円増(現預金34億円、売上債権・在庫共に50億円)、固定資産50億円増
部材調達の逼迫により、在庫を厚めに運営
- 負債合計は336億円(買掛債務増加を主因に64億円増加)
- 純資産は994億円(122億円増加)
- 自己資本比率は74.0%、3月末の有利子負債残高は13億円

単位：億円		2015年度	2016年度	2017年度
現金等 期首残高		268	273	338
営業活動	税引前・償却前利益	155	169	200
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	- 42	- 1	- 42
	納税	- 38	- 36	- 59
	その他	- 3	- 4	11
	小計	72	128	109
投資活動		- 38	- 35	- 46
フリーキャッシュフロー		34	93	63
財務活動	社債・借入	- 5	- 3	- 0
	株式・配当金、他	- 23	- 26	- 31
	小計	- 28	- 30	- 32
増減額(含 換算差額・連結範囲変更)		+ 5	+ 65	+ 33
現金等 期末残高		273	338	371

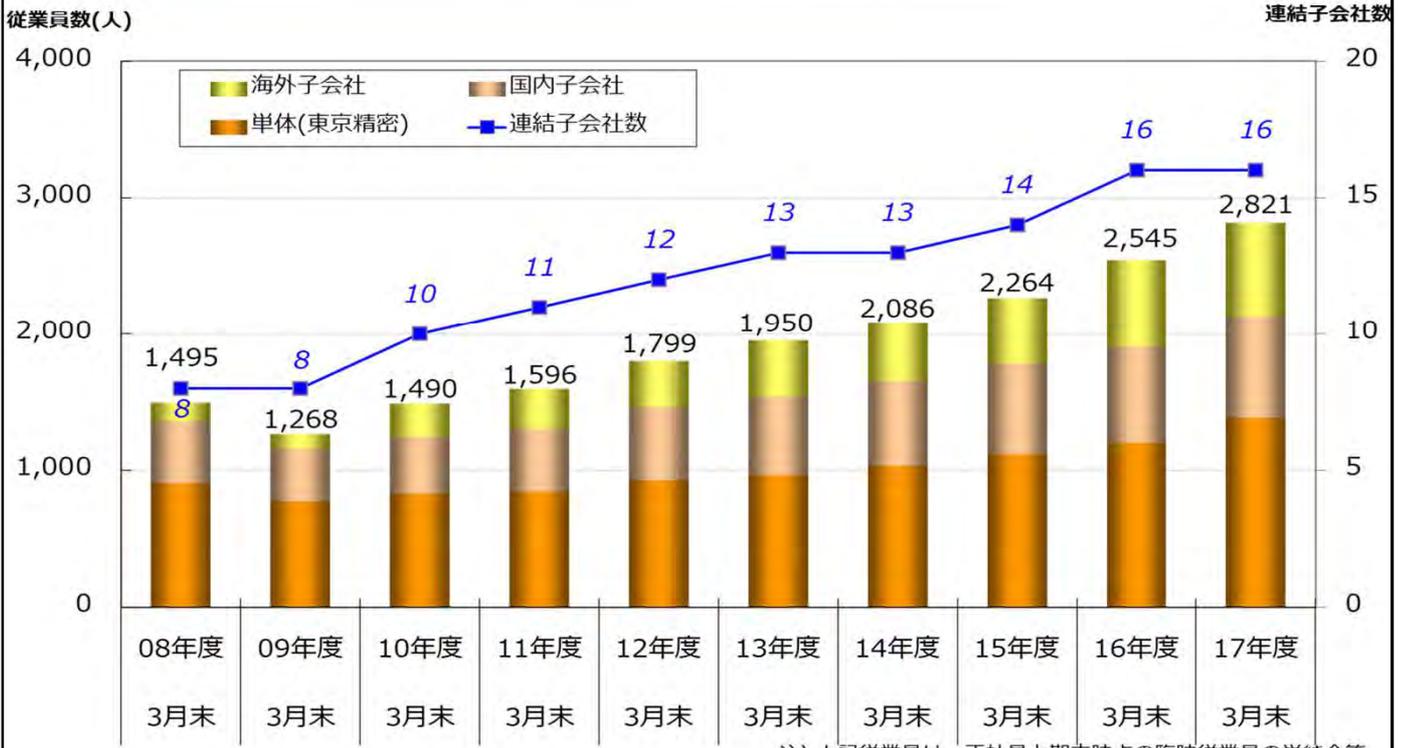
May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

15

- 17年度のキャッシュフロー（以下CF）について
 - 営業CFは109億円のプラス（利益計上が主因）
 - 投資CFは46億円のマイナス（機械設備やERPの投資が主因）
 - この結果、17年度フリーCFは63億円
 - 財務CFは32億円のマイナス

- この結果、期末の現金等の残高は371億円となった



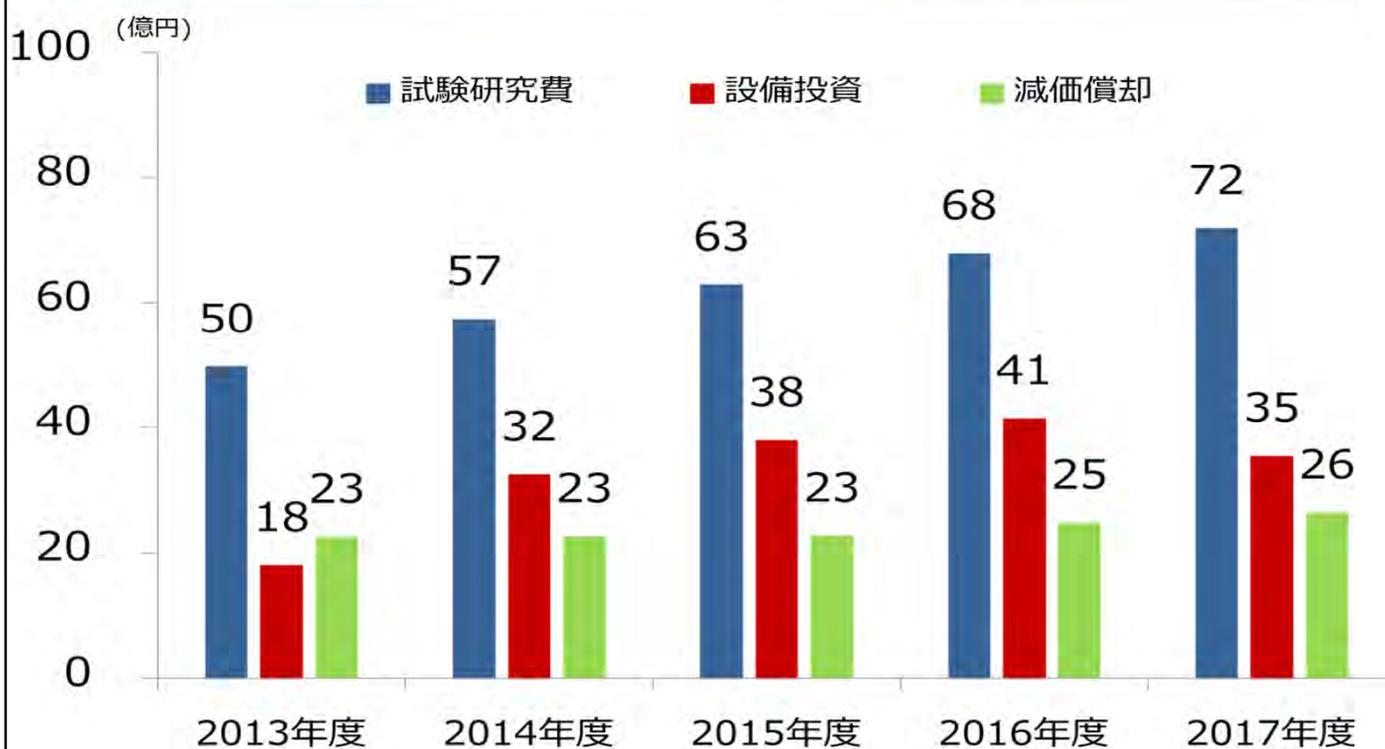
注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

16

- 3月末の連結従業員数（正社員+期末臨時従業員）は2,821名 前年3月末比 276名増
- 増加の主な要因は、
 - 半導体事業での製造・開発人員の増加
 - 中国での市場拡大に伴うサービス人員の増加



May 15th, 2018

Copyright © 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

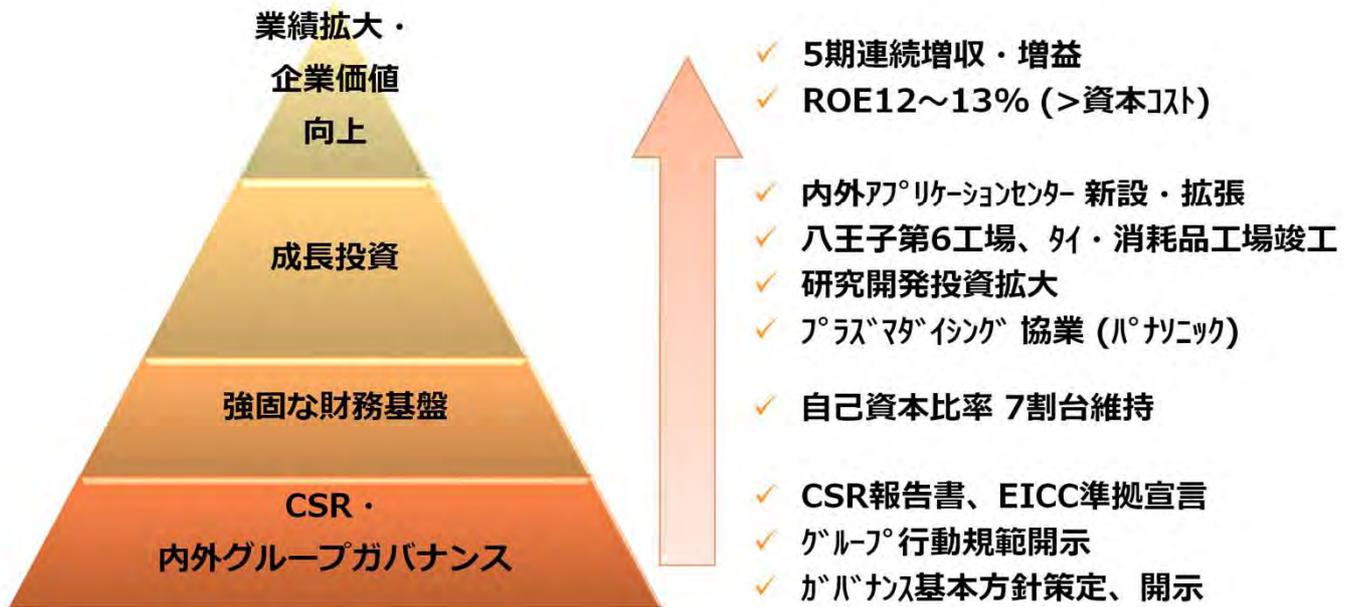
17

- 17年度の試験研究費実績は72億円（製品競争力強化、売上比 8.2%）
- 同 設備投資実績は35億円（工作機械の更新投資、ERPシステムなど）
- 同 減価償却は26億円

次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ **中期目標の進捗**
- ◆ 新 中期目標
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ 質疑応答

企業理念実現のための枠組み

主な実績
(~ 2017年度)

- 確固とした「CSR・内外ガバナンス」の土台の上に強固な財務基盤を踏まえた成長投資を積み上げていくことで、業績拡大ひいては企業価値の向上が実現
- 取り組みの結果として、5期連続の増収増益、資本コストを上回るROE水準を維持

各セグメントの中期方向感

主な実績
(~ 2017年度)

半導体

No.1製品強化
新技術とソリューション強化

- ✓ メモリ市場向けマルチチャックローバ
- ✓ 車載・電子部品向け取引拡大
- ✓ ダイナミックブレードの販売拡大
- ✓ 難削材ラインダの販売拡大

計測

No.1製品強化
海外需要取り込み
新規市場創出

- ✓ 航空機関連取引の拡大
- ✓ 自動化用途で海外市場開拓
- ✓ 光計測製品 受注開始

+α

精密技術を応用



- ✓ 専任部署設立
- ✓ PEファンド・VBへの出資

- 半導体ではNo.1製品強化と、新技術・ソリューション強化に力点を置いた活動を実施
- 計測ではNo.1製品強化、海外需要取り込みと、新規市場創出に注力
- 第3の事業セグメント確立に向けた戦略としては、専任部署を設立、プライベートエクイティファンドやベンチャービジネスへの出資を実行



◆ 長期指標：ROE 10%以上 → 維持

◆ 中期目標(～18年度)：営業利益 既往ピーク 150億円の更新 → 1年前倒し達成

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

21

- 長期指標「ROE10%以上維持」
中期目標(～2018年度)「営業利益 既往ピーク150億円の更新」
- これに対し、17年度ROEは13.8%
営業利益目標は1年前倒し達成
- 17年度営業利益が目標を大きく上回ったことから、18年度より新たな中期目標を設定

次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ **新 中期目標**
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ 質疑応答

**世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品
を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく**

理念を示すモットー:

「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」
WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products

コーポレートブランド:

ACCRETECH

“Accrete (共生)” と “Technology(技術)” の合成語

- 長期指標のベースにある、当社の企業理念
「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して
世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく」
- これを簡潔に表すモットー、及びコーポレートブランド
「ACCRETECH（アクレーテク）」を掲げ、理念の実現に取り組んでいる

企業理念実現のための枠組み



当社事業構成の特徴

半導体

- ・ 強み:
 - ・ 精密位置決め制御技術
 - ・ 内製化
- ・ チャンス:
 - ・ 新技術・新デバイス

計測

- ・ 強み:
 - ・ 高精度・高分解能測定技術
 - ・ 信頼性
- ・ チャンス:
 - ・ 新分野・海外需要

- ・ **バランスの取れた事業構成**
 - 異なる事業領域を有することによる
安定性(需要変動影響を吸収)

- 理念実現のための枠組みや当社事業構成の持つ強みなど、
当社の土台をなす基本部分に変わりはない
- また、需要の波が異なるセグメントを有する事業構成が全社業績安定に寄与している

ネットワーク・通信を軸に新技術が発展、連鎖的な成長フェーズへ



May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

25

- 中期目標の前提となる外部環境について
- 通信技術が急速に進歩し、関連技術や事業が拡大
これらの技術がモノづくりに適用されることで、FAやIoT(モノのインターネット)が更に進化
- 結果、データ、人、モノの往来が拡大するなど、連鎖的な革新が進むと予想

半導体：新たな成長ステージ

- ネットワーク関連：メモリ、電子部品、センサ
- 車載関連：センサ、パワー、SiC基板
- 中国需要：投資本格化、新工場建設（～2019年）

計測：持続的な成長の継続

- 自動車：プラットフォーム革新、内燃機関 開発継続
- 工作機械：需要拡大に伴うゲージ需要，IoT
- 航空機：特に新興国の中型ジェット機 需要

- 当社事業の成長ファクター
- 半導体は、ネットワーク関連、車載関連の需要が安定成長
更に中国での投資本格化により、少なくとも今後2年は安定した引合を予想
- 計測は、自動車のプラットフォーム革新、内燃機関の開発継続、
モノづくりの自動化に伴うゲージ類の引合が安定推移、
更に航空機需要も堅調が予想され、安定成長が維持されると予想

長期指標：ROE10%以上

中期目標：営業利益220億円
(2020年度迄に)

両輪にて達成

売上拡大
(1,100億円を目指す)

利益率向上
(営業利益率20%以上を目指す)

- 定量目標
- 長期指標：ROE 10%以上維持
- 中期目標：20年度迄に営業利益220億円達成
売上拡大と利益率向上の両輪で達成を目指す
- 成長のための積極的な投資を計画
投資関連コスト負担を乗り越えてのチャレンジングな目標の達成を目指す

技術面

製品競争力強化、対象市場拡大

生産面

**生産キャパシティの拡充
効率改善 (自動化・省人化)**

利益率改善

**ERP導入による情報共有化促進
サービス (フィールド、エンジニアリング) , 消耗品売上の拡充****中期目標達成**

- 目標達成のための全社戦略
- 技術面：積極的な研究開発による、既存製品の競争力強化、対象市場拡大
- 生産面：工場新設など生産キャパシティ拡大検討
自動化や省人化を通じた生産効率改善
- 利益率改善：ERP導入による情報共有化によるビジネスの効率化
サービス及び消耗品売上の拡大

個別製品/技術への対応

プローバ

- デパート化戦略の継続
(デバイス・顧客に最適なプラットフォーム、オプションの提供)



メモリ向けマルチチャックプローバ

ダイサ・ブレード

- ソリューション構築・提供
- オプション機能拡大
- 次世代デバイス対応
- 新技術(レーザー, プラズマ)



ダイサ・ブレード

研削装置

- 最先端テクノロジー対応
(TSV, 3D, FOWLP/PLP...)
- 新材料(SiC等)の展開



ポリッシュラインダ

CMP

高剛性ラインダ

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

29

- 半導体事業の戦略
- プローバ：デパート化（個別条件に最適なプラットフォーム・オプションの開発）の継続
- ダイサ・ブレード：最善ソリューションの提供、次世代デバイス向けなど先端技術対応
- 研削装置：技術革新が著しく、新材料も増加、これらに対応する技術開発を継続



製品/ソリューションによる差異化と販路拡大



製品開発

- ハイエンド機強化
- エントリー機, ゲージ類拡充
- 光学測定機器
ラインナップ拡充

ソリューション

- エンジニアリング, 保守, 受託
ビジネスの強化
- 自動測定機能
- 対応インターフェース

販売活動

- 海外地域別戦略の遂行
- アプリセンター拡充
- 新業界開拓



超高精度 真円度測定機



高精度 三次元座標測定器



現場向け 粗さ測定器

ATC対応無線ポアゲージ



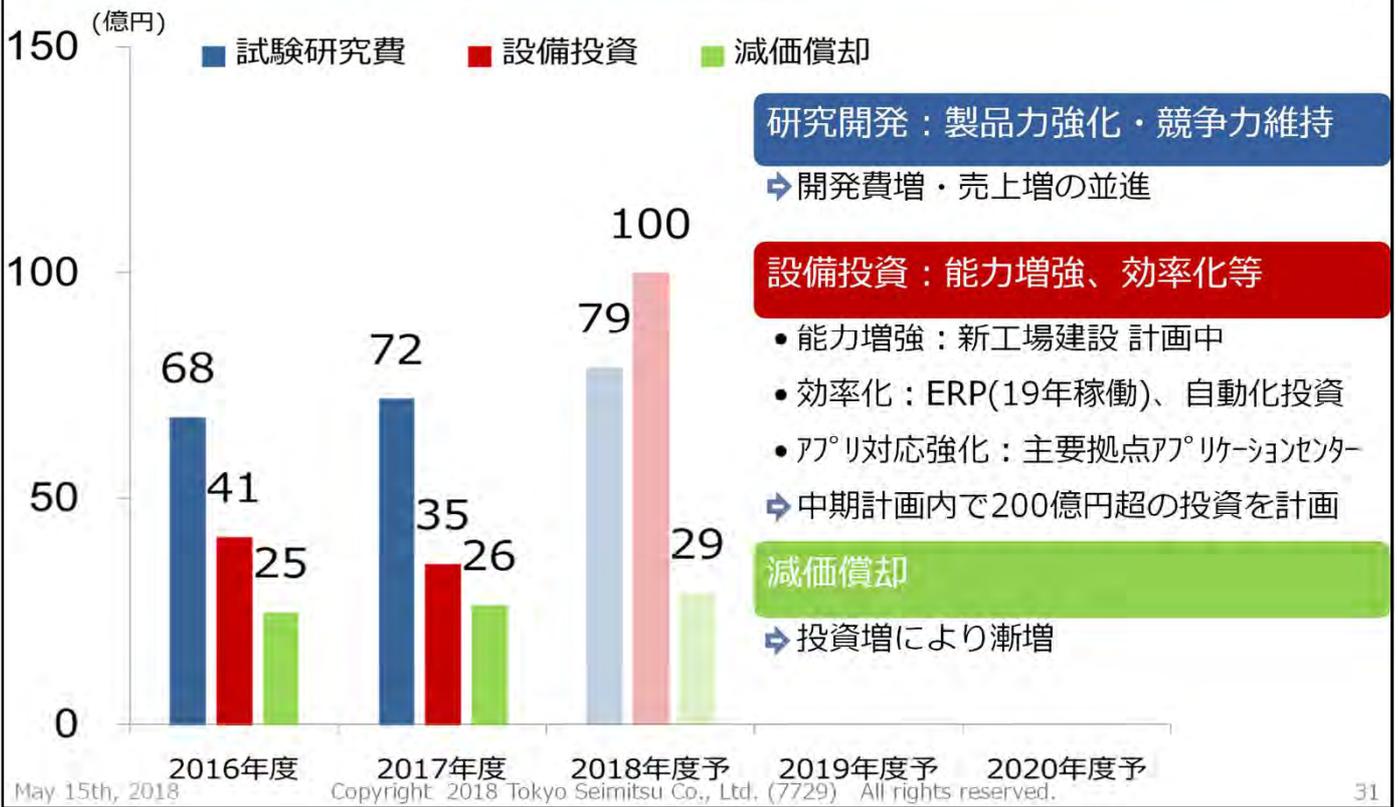
非接触 三次元粗さ・形状測定機
(ウェーハ専用モデル)

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

30

- 計測事業の戦略
- 製品開発：ハイエンド～エントリー機、並びに各種光学測定機器などラインナップ拡充
- ソリューション：各種サービスを通じた関係強化、並びに自動化ソリューションの提供
- 営業活動：海外各地域別の戦略、アプリケーションセンター拡充、新業界開拓



- 試験研究：研究費増加→売上増加→研究費増加の循環による製品力強化に注力
- 設備投資：工場建設（計画中）、ERP・自動化、など積極対応
 中期計画期間（～20年度迄）で200億円超の投資を計画
- 減価償却：多少増加する見込み
 投資による売上増・利益率改善で乗り越えたい
- 18年度計画は試験研究費 79億円、設備投資100億円、減価償却費29億円

- 財務健全性を維持しつつ、成長投資に注力
- 配当は、業績連動の利益配分を基本に、連結配当性向30%を目安に実施
- 18年度は、創業70周年記念配当(20円)実施、通期配当計画114円

1株配当推移

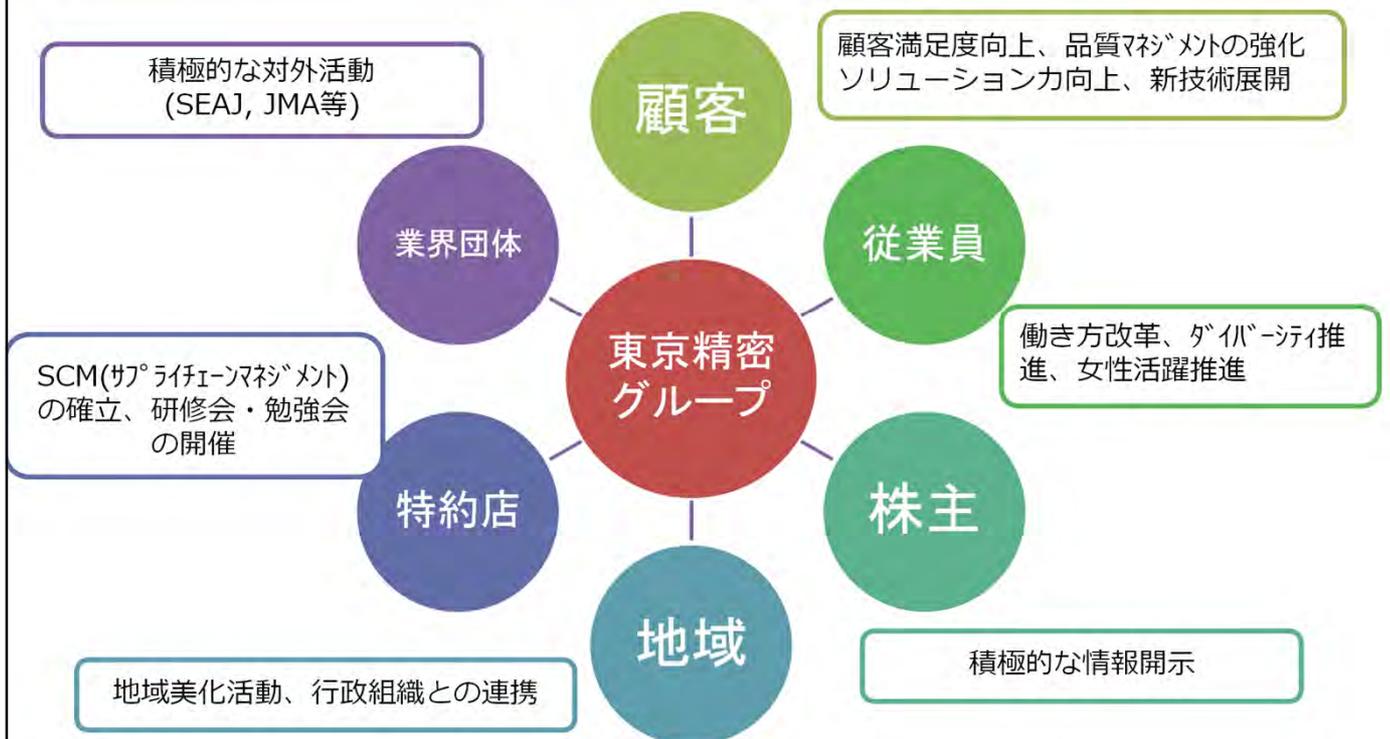


May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

32

- 株主還元は、当面 配当中心（連結配当性向 30%を目安に運営する方針）
- 18年度は、普通配当 1株あたり94円に加え、創業70周年記念配当 同20円を行う予定（詳細は、2018年5月15日公表ニュースリリースをご覧ください）
- 今後も意欲的に投資を行う検討を行うが、投資に当たっては手元資金活用を基本にしつつ、財務の健全性とのバランスも考慮してすすめていく



- 当社は「持続可能な社会の実現」に向け、CSR活動に積極的に取り組んでいる
- 当社事業活動は、様々なステークホルダーとの関わりによって成り立っている
したがって、全ての事業活動プロセスにおいて、双方向コミュニケーションを重視

Environment(環境)

- 環境考慮製品：LCAを考慮した環境配慮型製品の開発
- 温暖化防止：CO2排出量削減
- 資源削減：水使用量削減、廃棄物リサイクル率向上

Social (社会)

- 品質向上、作業安全：変更点管理プロセスの強化、QMS活動、事故率低減
- サプライチェーン：当社方針に基づき、サプライヤと協力してESGの強化改善を実施
- 他：働き方改革(女性活躍推進等)、コンプライアンス、八王子/土浦市 アドプト活動

Governance(ガバナンス)

- グループ行動規範：全拠点への教育、浸透、見直し
- コンプライアンス：遵守体制の構築、教育、見直し
- 情報セキュリティ強化：社内管理システム強化、点検体制、管理教育



- 当社のESGについて行う取り組み
- 当社は、EICC準拠を宣言のうえ、ISO26000に準じて活動
- 今後は、国連のグローバルコンパクトや関連するイニシアティブへの積極的な参加と活動を検討していきたい
- 18年度は、各種の取り組みを、具体的な目標をもって実行する

次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 新 中期目標
- ◆ **2018年度業績予想**
- ◆ 質疑応答

半導体

- 足許受注は引き続き堅調
- 生産は部材調達の逼迫状態が続く
- スマートフォン部品向け装置の発注タイミング等が不透明で先行きが見通しづらい状況

計測

- 国内モノづくり需要は堅調さを維持
- 海外、特に中国の引合い増加に期待
- 自動化対応、エンジニアリング対応への引合増加を見込む

- 半導体：スマートフォン関連需要に一部停滞が見られるものの、総じて堅調
生産は部材調達の逼迫に左右されている状態が継続
短期的には先行きが見通しづらいことを前提とした計画
- 計 測：国内モノづくり需要は引き続き堅調
海外（特に中国需要）は回復
自動化やIoT関連の引合増加を見込んだ計画

単位：億円（配当除く）	2017年度			2018年度			
	上期	下期	通期	上期 予想	下期 予想	通期 予想	前年比
売上高	437	445	882	482	468	950	+8%
半導体製造装置	303	292	595	337	317	654	+10%
計測機器	133	154	287	145	151	296	+3%
営業利益	89	84	173	97	88	185	+7%
同率	20%	19%	20%	20%	19%	19%	-
経常利益	90	83	173	97	88	185	+7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	64	64	127	69	62	131	+3%
1株配当	92円			114円(普通配94円、記念配20円)			+22円

*2018年度は 創業70周年記念配当を実施予定

May 15th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

37

○ 18年度業績予想

売上高 950億 (17年度比 8%増)

- 半導体 上期337億円、通期654億円(同10%増)

- 計測 上期145億円、通期296億円(同3%増)

営業利益 185億円 (7%増、上期97億円、下期88億円)

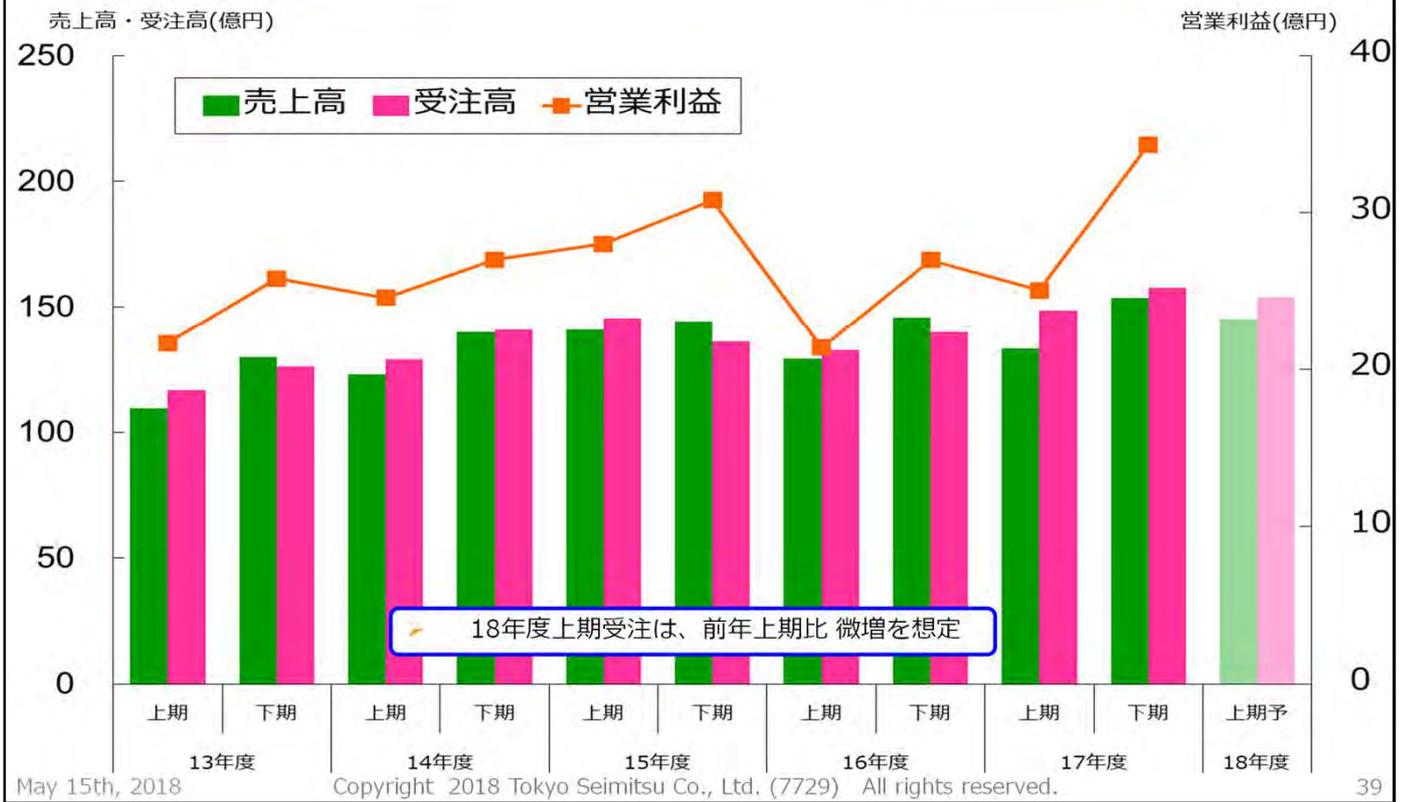
経常利益 185億円、純利益131億円

○ 配当は、通期配当計画 1株あたり114円 (普通配94円、記念配20円)

(詳細は、2018年5月15日公表ニュースリリースをご覧ください)



- 18年度上期の受注高は、17年度上期並みを想定
- 18年度上期の製品構成比の想定
 売上高：検査装置 6割台半ば、加工装置 ほぼ3割
 受注高：検査装置 ほぼ6割、加工装置 3割台前半



- 18年度上期の受注高は、17年度をやや上回る水準を想定
- 18年度上期の製品構成比の想定
売上高、受注高 共に、自動計測製品 3割台半ば、汎用計測 6割台半ば

次第

- ◆ 2017年度 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 新 中期目標
- ◆ 2018年度業績予想
- ◆ **質疑応答**



<http://www.accretech.jp/>